



LAM：领先的刻蚀设备供应商 聚焦刻蚀、薄膜、清洗三大领域



借鉴意义

LamResearch（泛林半导体）是全球领先的半导体设备公司之一，产品包括半导体刻蚀、薄膜沉积及清洗/去胶设备。本文通过对 LAM 产品现状、全球半导体设备行业情况、公司发展历程等方面展开研究，为投资者带来 LAM 的深度分析，并为投资者投资 LAM 或海外/国内半导体设备公司提供启发。

发现

领先的半导体设备制造商，聚焦于刻蚀、薄膜沉积、清洗/去胶设备。公司成立于 1980 年，主要从事刻蚀设备的开发，随后分别于 2008 年、2012 年收购 SEZAG 及 NovellusSystem，拓展其在清洗、薄膜沉积领域的产品组合及竞争力，目前公司客户覆盖镁光、三星、海力士、台积电等全球头部晶圆厂。公司 FY2022 收入达到 172.27 亿美元，其中系统业务达 113.22 亿美元（66%），服务业务达 59.05 亿美元（34%）。按客户应用领域来看，FY1Q23NAND 领域占比 39%，DRAM 领域占比 13%，代工领域占比 34%，逻辑及其他占比 14%。

产品组合覆盖半导体设备价值量约 50%，刻蚀领域市占率最高。根据 Gartner 测算，2021 年刻蚀、CVD、ALD、清洗、去胶等价值量占比分别为 25%、13%、4%、6%、1%，公司产品价值量覆盖约 50%。同时刻蚀设备领域，公司 2021 年市场份额达 46%，处于绝对领先优势，市占率远高于第二名 TEL（29%）；在 CVD、ALD、清洗等领域市占率分别达 23%、

9%、12%，均为全球前五的领先供应商。

2023 年晶圆厂资本开支或将承压，刻蚀、薄膜等关键工艺要求越来越高。受益于晶圆厂资本开支增加，SEMI 预计 2022 年晶圆加工设备同比增长 8.3%，达到 948 亿美元，2023 年受到存储器下滑、中美贸易摩擦等影响，预计同比下滑 16.8%至 788 亿美元，但从中长期角度而言，先进制程与存储技术升级驱动设备投资提升，尤其是 GAA 工艺、3DNAND 的层数堆叠以及 DRAM 制程缩小将驱动刻蚀、薄膜沉积等关键环节设备要求更高。

财务与估值

回顾历史，尽管公司产品线数量不多，但由于其聚焦的产品组合价值量较高，且在刻蚀设备领域市占率领先，驱动其营收及业绩高速增长，复盘 2016~2022 年，公司 P/ETTM 最高值为 31.3x，最低值为 8.2x，均值为 19.8x。

风险

市场竞争加剧及新产品研发不及预期；半导体行业周期性波动以及晶

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51626

